

客户 CUSTOMER: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书 SPECIFICATION

Preliminary

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式双工器

Multilayer Chip Diplexer

贵 司 料 号 YOUR PART NO.:
敝 司 料 号 OUR PART NO.: MDPX18M0917P69-D05M
版 本 号 VERSION.: V1.2

接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕様书已被我司接受 日期: DATE: 公司: COMPANY:		
批准 CFMD	审核 CHKD	接收 RCVD

本纳入仕様书共 6 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技有限公司
SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD
TEL: 86-755-28085000
FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
梁启新	付迎华	曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号
电话(Tel): 0755-28085000 传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

纳入仕様书改定履历 **MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION**

Ver.	DATE	CONTENT	APPROVED
1.0	2020.05.24	初稿 Constitute	梁启新
1.1	2020.08.11	更新产品外形 Modify the Product Appearance	梁启新
1.2	2020.08.17	更新产品功率容量 Modify Power Capacity	付迎华

目录 CATALOG

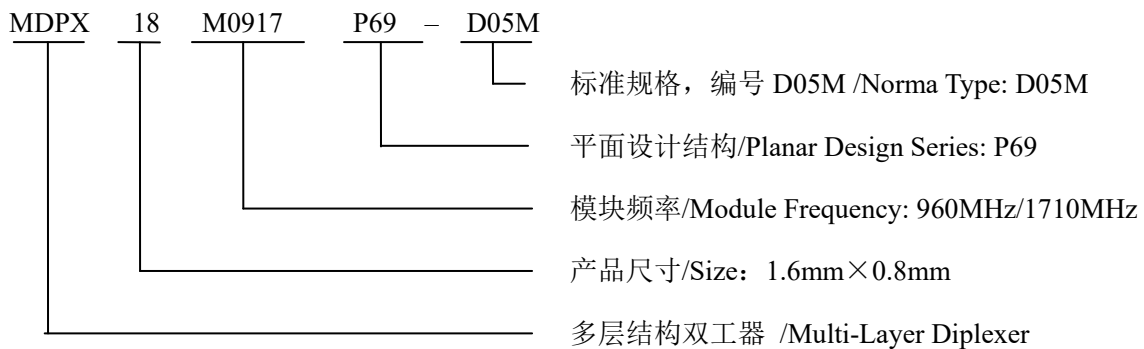
1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.....	4
4 测试条件 Testing Conditions.....	4
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.....	6

1 适用范围 Scope

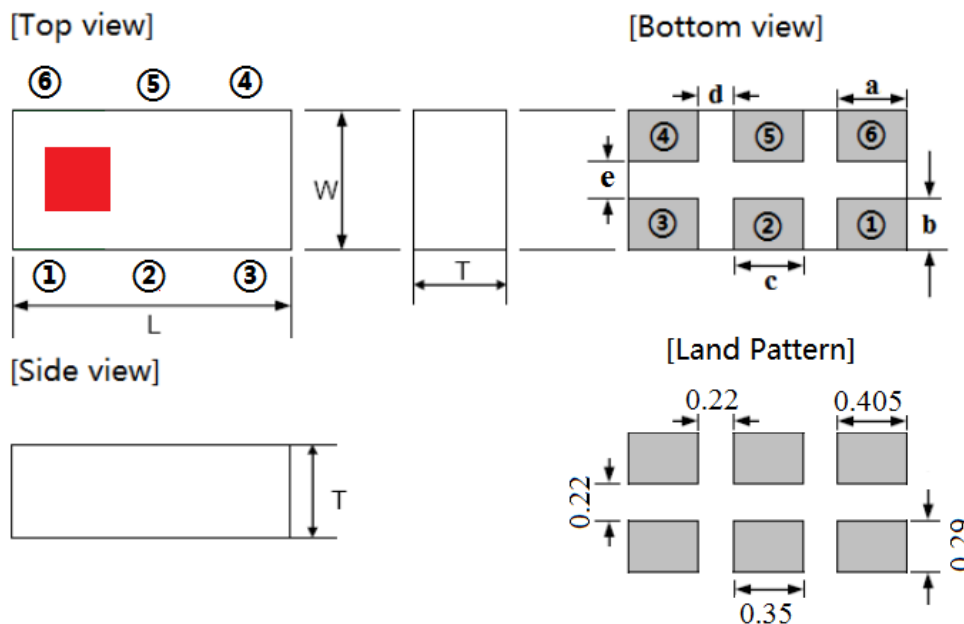
“麦捷”叠层片式双工器系列产品设计用于 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA 和无绳电话机等，具有低的插入损耗、高的隔离度和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

“Microgate” Multilayer Chip Diplexer series are designed to be used in 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA & cordless phones with low insertion loss and high isolation as well as small size SMD chip design , which can simplify your complex tuning and circuit design .

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



PIN Configuration

①	②	③	④	⑤	⑥
GND	Common Port	GND	Low Band Port	GND	High Band Port

Dimension:

Unit:mm

L	W	T	a	b	c	d	e
1.6±0.15	0.8±0.15	0.7±0.1	0.405±0.1	0.29±0.1	0.35±0.1	0.22±0.1	0.22±0.1

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

4

4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (-40 to +85°C)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85°C

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85°C

No.	Item (项目)	Frequency (MHz)	Specifications (特性)
5.1	Insertion Loss (in f1) 插入损耗	699~960	0.55dB Max @25°C
			0.6dB Max @-40°C~85°C
5.2	Insertion Loss (in f2) 插入损耗	1710~2690	0.5dB Max @ 25°C
			0.6dB Max @-40°C~85°C
5.3	VSWR (in BW) 回波损耗 (in f1 & f2)	699~960	1.5 Max
		1710~2690	
5.4	Attenuation 阻带衰减 (in f1)	1406~1496	3.5dB min.
		1554~1574	12dB min.
		1648~1724	20dB min.
		1760~1830	25dB min.
		2109~2361	25dB min.
		2472~2586	29dB min.
		2640~2745	27dB min.
		3400~3600	21dB min.
5.5	Attenuation 阻带衰减 (in f2)	4905~6500	18dB min.
		699~915	20dB min.
		4905~5150	20dB min.
		5150~6500	25dB min.
	Isolation 隔离度	699~960	20dB min.
		1710~2690	25dB min.
5.6	In/Output Impedance 输入/输出阻抗		50 Ω
5.7	Max Power		4W

6 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

- ① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

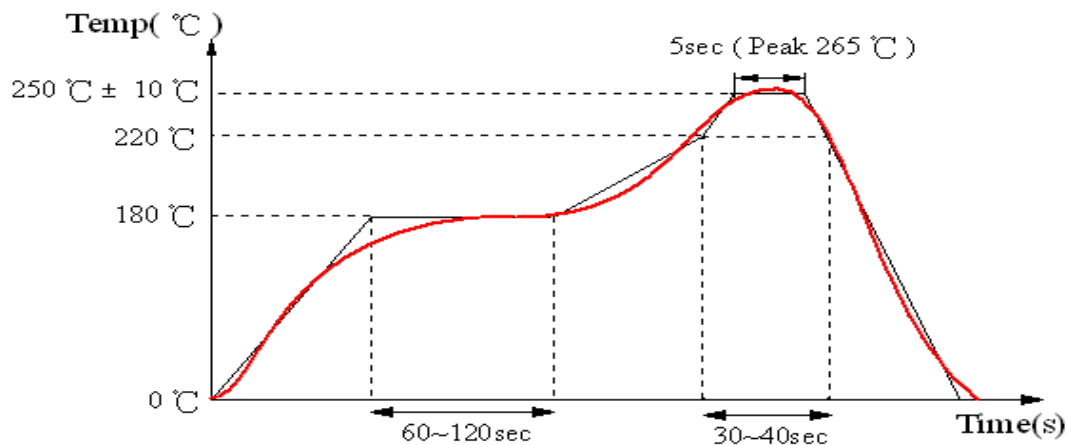
- ② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

- 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150°C，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100°C。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150°C max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100°C max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

- 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150°C, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	280°C max
输出功率 Soldering iron output	30w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max